

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-011

精伦电子股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。公司全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”）以其名下自有房产向交通银行上海浦江高科技园支行申请办理流动资金贷款900万元，并授权鲍麦克斯管理层或者授权代表签署相关协议及办理相关手续。

一、本次贷款的基本情况

公司全资子公司鲍麦克斯拟以其名下自有房产，向交通银行上海浦江高科技园支行申请办理流动资金贷款人民币900万元，贷款期限为一年。

公司及全资子公司与交通银行上海浦江高科技园支行不存在关联关系，不构成关联交易，本次抵押事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、抵押人基本情况

企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-103室

法定代表人：顾新宏

注册资本：7692.3万元

经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以上咨询除经纪），从事货物与技术的进出口业务。

三、抵押资产情况

本次拟抵押的资产为公司全资子公司鲍麦克斯名下自有，坐落于上海市闵行区浦江镇新骏环路88号12幢501室房产，房地产权证号：沪房地闵字（2013）第58073号。

除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、对上市公司的影响

本次抵押贷款事项是基于全资子公司目前经营情况综合考虑，有利于其持续健康发展，不会对公司及鲍麦克斯生产经营和业务发展造成不利影响，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024年3月13日